

<<微电子器件封装制造技术>>

图书基本信息

书名：<<微电子器件封装制造技术>>

13位ISBN编号：9787121153983

10位ISBN编号：712115398X

出版时间：2012-1

作者：王开建

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<微电子器件封装制造技术>>

内容概要

本书主要内容包括：微电子器件封装技术概述；微电子器件塑料封装技术，以三端稳压器塑料封装、BGA塑料封装、WL-CSP塑料封装为具体学习任务等。

<<微电子器件封装制造技术>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>